

2月市场洞察报告

半导体市场分析与趋势展望

洞察行情 精准决策

“DISTINCTIVE
INSIGHTS,
INFORMED
DECISION-MAKING”

序言

本报告由安芯易电子商务（深圳）有限公司推出，旨在为客户、供应商及合作伙伴提供半导体行业资讯及市场趋势预测，报告涵盖宏观动态、半导体产业动态、终端市场动态、重点产品行情、市场重点趋势等模块，助力行情洞察、精准决策。

本报告每月更新，可关注安芯易电子订阅号，及时获取报告发布等信息。您可以通过联系安芯易客户经理或通过 marketing@360ic.com 获取完整版报告。

目录

摘要	1
一、宏观动态	2
（一）经济景气跟踪	2
（二）行业需求动态	2
（三）资本市场动态	3
（四）产业政策动态	4
二、半导体产业动态	4
（一）短期影响	5
（二）中期影响	6
（三）长期影响	6
三、终端市场动态	7
（一）人工智能	7
（二）新能源	8
（三）汽车	8
四、重点产品行情	8
（一）存储：终端需求上涨承压，部分存储芯片贸易氛围浓烈	8
（二）功率：总体仍处于供过于求阶段，价格上涨动能不足	9
（三）被动：订单需求放缓，预计第一季度 MLCC 出货环比减少 7%	9
（四）MCU：整体市场持续疲软，部分通用类器件交期缩短	10
五、市场重点趋势	10
信息来源	12
免责声明	13

摘要

2024 年 2 月重点行情趋势	
宏观趋势	▪ 全球经济景气上行，中国高端制造业延续增长态势、美国低于市场预期 ▪ 中国半导体市场增长表现靓丽，日本及欧洲地区需求疲软
产业动态	▪ AI 继续火热，存储大厂 HBM 产能售罄，看好高端存储芯片行情 ▪ 供应链库存调整可能仍在继续，半导体行业尚未全面复苏
终端市场	▪ 人工智能：Sora 发布，加速 AI 大模型应用升级 ▪ 新能源：美国或将停用国内龙头厂商的电池产品，但整体影响较小 ▪ 汽车：欧洲市场需求疲软，零部件供应商陆续裁员，降本增效或将成为主旋律
产品行情	▪ 存储芯片：高端产品延续增长，但终端需求承压、贸易需求主导 Wafer 市场 ▪ 功率芯片：总体仍处于供过于求阶段，价格上涨动能不足 ▪ 被动元件：订单需求增长放缓，Q1 出货量或将环比减少 7% ▪ MCU：整体市场持续疲软，部分通用类器件交期进一步缩短

一、宏观动态

（一）经济景气跟踪

● 全球经济景气上行，中国高端制造业延续增长态势、美国低于市场预期

24 年 2 月，根据 JP Morgan 数据，全球制造业 PMI 为 50.3，回升至荣枯线以上。

分区域来看：

亚洲方面，中国地区制造业 PMI 仍然位于收缩区间，表现低于去年同期；但高技术制造业 PMI 为 50.8，连续 4 个月保持在扩张区间，行业延续增长态势。日本制造业 PMI 持续走弱，韩国经济则表现相对强劲。受益于西方国家产业链转移及本土产业政策扶持，印度制造业景气度持续向上。

美洲方面，美国 ISM 制造业 PMI 仅为 47.8，大幅低于市场预期值和前值，连续两个月反弹后再次走弱。墨西哥制造业 PMI 连续多月处于荣枯线以上，增长动能持续。

欧洲方面，欧元区制造业 PMI 仍处于收缩区间，经济表现延续疲软态势。

全球各地区制造业 PMI

时间	全球	中国	日本	韩国	印度	美国	墨西哥	欧元区
2023-02	49.90	52.60	47.70	48.50	55.30	47.70	51.00	48.50
2023-03	49.60	51.90	49.20	47.60	56.40	46.30	51.00	47.30
2023-04	49.60	49.20	49.50	48.10	57.20	47.10	51.00	45.80
2023-05	49.60	48.80	50.60	48.40	58.70	46.90	50.50	44.80
2023-06	48.80	49.00	49.80	47.80	57.80	46.00	50.90	43.40
2023-07	48.70	49.30	49.60	49.40	57.70	46.40	53.20	42.70
2023-08	49.00	49.70	49.60	48.90	58.60	47.60	51.20	43.50
2023-09	49.10	50.20	48.50	49.90	57.50	49.00	49.80	43.40
2023-10	48.80	49.50	48.70	49.80	55.50	46.70	52.10	43.10
2023-11	49.30	49.40	48.30	50.00	56.00	46.70	52.50	44.20
2023-12	49.00	49.00	47.90	49.90	54.90	47.40	52.00	44.40
2024-01	50.00	49.20	48.00	51.20	56.50	49.10	50.20	46.60
2024-02	50.30	49.10	47.20	50.70	56.90	47.80	52.30	46.50

数据来源：Choice 数据库

（二）行业需求动态

● 全球半导体市场继续回暖，中国增长表现靓丽、日本及欧洲地区需求疲软

24 年 1 月，受行业淡季周期影响，全球半导体销售额环比有所下滑，但同比增长 15.2%，市场需求表现优于去年同期。

分区域来看：

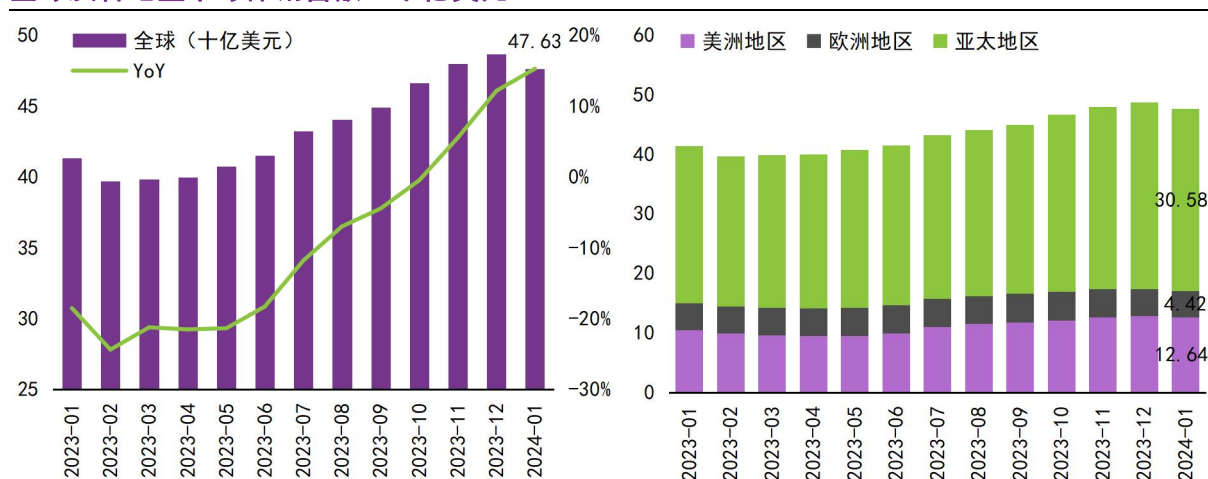
亚太地区，整体市场需求表现良好，同比增速为 16.1%，市场份额 64.2%。其中，中国地区增速表现靓丽（同比+26.6%）。受地震及经济低迷影响，日本地区需求增长陷入低谷（同比-6.4%），

占全球市场份额为 7.71%，呈现下滑趋势。

美洲地区，市场需求持续复苏、增速较快（同比+20.3%），可能得益于美国《芯片法案》助力行业发展，加之墨西哥市场持续吸引外来产业投资，带来芯片需求增长。

欧洲地区，销售额同比略微下降，主要系整体经济景气度下行，其中汽车行业近期需求增长疲软。

全球及各地区半导体销售额（十亿美元）



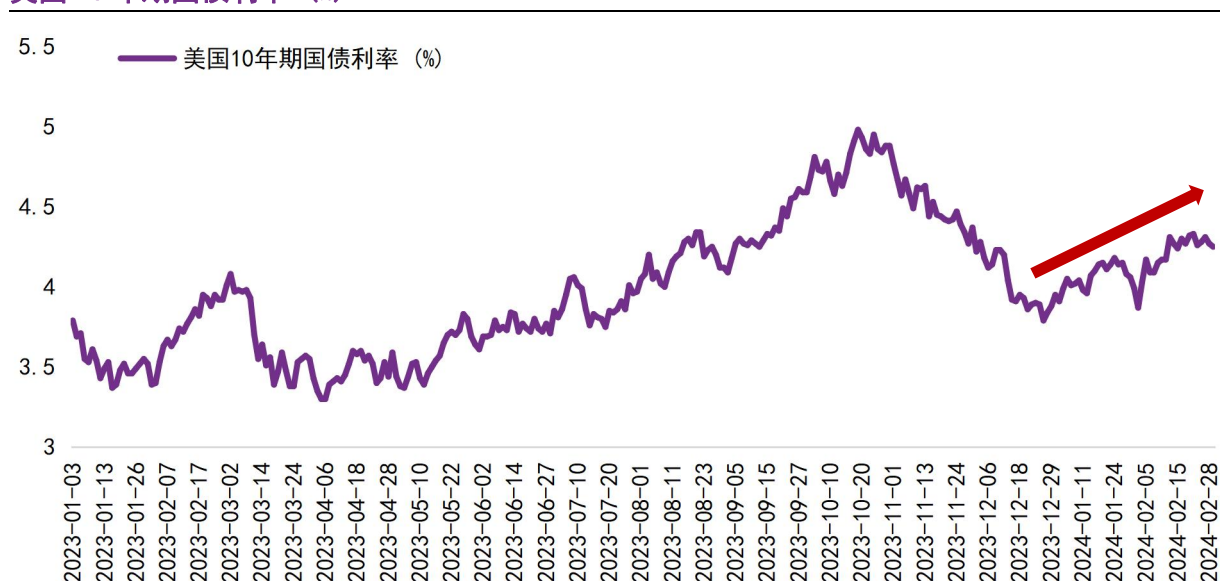
数据来源：SIA

（三）资本市场动态

● 美联储降息节奏放缓，可能冲击芯片进出口贸易

24 年 2 月，美国 10 年期国债利率整体继续回升，主要原因是近期美国国债持续增发、供需失衡所致。另一方面，美联储降息节奏放缓，将使利率保持相对高位，抬升美元汇率，并继续冲击芯片进出口贸易。

美国 10 年期国债利率 (%)

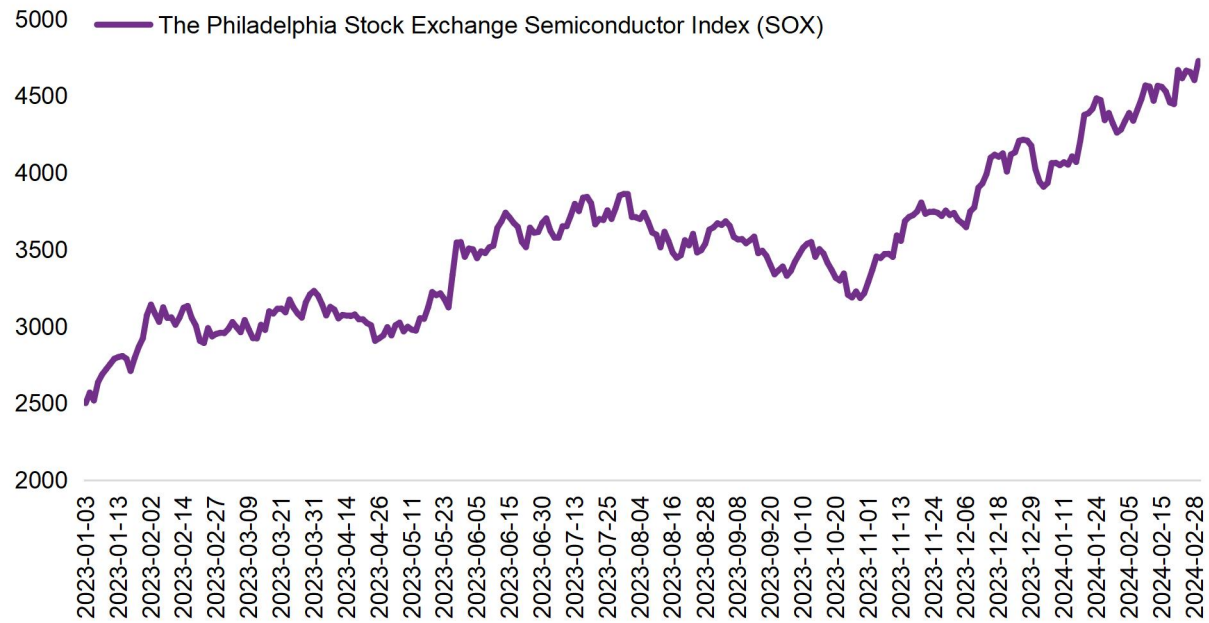


数据来源：Choice 数据库

● 英伟达业绩表现优异，推动费城半导体指数高位上涨

费城半导体指数（SOX）维持高位上涨，主要得益于英伟达靓丽业绩带来的股价飙升。

费城半导体指数（SOX）



数据来源：Choice 数据库

（四）产业政策动态

● 美国对中芯国际制裁加码，但整体影响有限

据报道，美国正对中国芯片制造商中芯国际加大施压力度，切断其工厂从美国进口更多产品的机会。

● 印度批准建设三座半导体工厂，服务于国防、汽车及电信等领域

近期，印度正式批准塔塔集团、CG Power 等公司建设 3 座总投资 1.26 万亿卢比（约合 152 亿美元）的半导体工厂项目，以实现电子强国目标。其中，塔塔集团与力积电合作的 1 座工厂为晶圆厂，另外 2 座为封测工厂，并为国防、汽车和电信等行业生产和封装芯片。

● 日本将为台积电第二家工厂提供资金补贴，夯实以资本为纽带的半导体供应链联盟

日本将额外提供 7320 亿日元的补贴，为台积电在熊本的第二家工厂提供资金。台积电在日本的子公司中引入日本索尼集团、丰田汽车、电装公司，可见日本正在形成以资本为纽带的半导体生产与应用的供应链联盟。

二、半导体产业动态

半导体产业动态概览			
维度	厂商	经营动态	解读
短期影响	SK 海力士	24 年 HBM 产能全部售罄	HBM 需求持续增长
	英伟达	数据中心业务收入暴增 409%	云端算力需求持续增长

	Microchip	计划对与工厂关闭无关的员工减薪 10%，并对其管理团队减薪 20%	MCU 市场需求继续疲软
	铠侠	结束减产，预计产能利用率恢复到 90%	看好存储芯片市场行情
	TI	拟对位于北京的低端电源芯片研发团队进行裁撤	消费市场需求持续疲软，国产替代进程加快
中期影响	三星	暂停兴建 P5 晶圆厂新生产线，优先建造 P4 工厂 PH2 产线	看好代工需求增长
	台积电	预计 24 年营收将增长 21%-25%	受益于 AI 需求爆发，台积电业绩增长有望高于行业平均
	中芯国际	认为 24 年智能手机和 PC 总量增长有限，行业并未全面复苏	供应链库存调整仍在继续，半导体行业尚未全面复苏
	力积电	预期 24 年 Q1 产能利用率回升到 70-75%	晶圆代工行业有所回暖
	联电	预期 24 年 Q1 产能利用率降至 61%至 63%	供应链库存调整仍在继续
	世界先进	预期 24 年 Q1 产能利用率降至 50%	供应链库存调整仍在继续
长期影响	SK 海力士	将赴美国印第安纳州打造先进封装厂	英伟达在美供应链实现闭环
	村田	旗下子公司出云村田制作所规划在日本岛根县兴建新工厂	看好 MLCC 长期需求
	国巨	将在中国台湾建设第六座厂区，引入晶圆电阻、MLCC 生产线	看好 MLCC 长期需求
	英飞凌	与本田战略合作，为本田提供技术支持	原厂与车企之间的合作愈加深化

（一）短期影响

● 英伟达数据中心业务收入暴增，云端算力需求持续增长

英伟达 FY24Q4 实现收入 221.0 亿美元，其中数据中心业务收入为 184.0 亿美元（同比+409%，环比+27%）。Q4 数据中心的增长主要受益于 NVIDIA Hopper GPU 计算平台以及 InfiniBand 端到端解决方案的出货量增加。

AI 商业浪潮的迭起，英伟达的估值已迈入 2 万亿美元行列，其护城河主要有三道：芯片速度快、高性能芯片网络、构成行业标准的软件平台 CUDA。未来随着 AI 商业化进程加快，英伟达的业绩及估值有望继续增长。

● 微芯科技减薪最高 20%，MCU 市场需求继续疲软

美国 MCU 制造商微芯科技正在实施员工减薪措施，计划对与工厂关闭无关的员工减薪 10%，并对其管理团队减薪 20%。

● HBM 供不应求，存储大厂产能售罄

随着 AI 芯片需求持续大涨，作为目前 AI 芯片的关键器件，HBM 持续供不应求。继此前美光宣布 24 年 HBM 产能全部售罄后，SK 海力士 24 年 HBM 产能也已全部售罄。

● 存储大厂铠侠结束减产，看好存储芯片行情

鉴于半导体市场逐渐改善，铠侠宣布将审查自 2022 年以来的闪存减产计划，并扩大生产。根据需求，预计到今年 3 月份，产能利用率将恢复到 90%左右。

- **TI 拟对位于北京的低端电源芯片研发团队进行裁撤，寻求优化业务布局**

据报道，TI 裁撤位于北京的芯片设计团队，该团队主要负责较为低端的电源芯片研发，大约有 50 人左右。TI 裁撤的中国产品线将转移至印度，寻求业务布局优化。这一调整主要源自消费市场需求疲软，以及国产替代进程加速的影响。

（二）中期影响

- **三星暂停建设 P5 工厂，优先完成 P4 无尘室以应对市场需求**

三星半导体调整韩国平泽 P4 工厂建设进度，以便优先建造 PH2 产线（用于代工业务），暂停兴建 P5 晶圆厂新生产线。另外，三星 P4 晶圆厂还将兴建 PH3 产线，用于生产 DRAM 等存储芯片。

- **各大晶圆代工厂商认为供应链库存调整仍在继续，半导体行业尚未全面复苏**

台积电认为 24 年半导体库存将恢复到更为健康的水平，预计全年营收增长 21%-25%。中芯国际认为需求复苏的强度尚不足以支撑半导体全面强劲反弹，24 年智能手机和 PC 总量增长有限。联电预计 24 年 Q1 晶圆出货量将环增 2%-3%，产能利用率约 61%-63%。力积电预期 24 年 Q1 产能利用率有望回升到 70%-75%。世界先进认为车用、工业供应链将持续库存调整，24 年 Q1 产能利用率将降至约 50%。

（三）长期影响

- **SK 海力士将赴美建设先进封装厂，英伟达在美供应链实现闭环**

SK 海力士将赴美国印第安纳州打造先进封装厂，主要以 3D 堆叠制程打造 HBM，未来会整合进英伟达的 AI GPU。加上台积电亚利桑那州的芯片制造工厂，未来英伟达的 GPU 芯片将能够实现在美国本地化生产。

- **业界看好 MLCC 长期需求，村田、国巨等大厂计划扩产**

业界认为，MLCC 中长期需求将保持增长，随着智能手机、汽车、通信设备、IoT、AI 服务器等终端需求增加，将拉动各类 MLCC 电容需求。尽管当前 MLCC 仍处于去库存进程中，但被动元件大厂如村田、国巨等，近期均宣布 MLCC 扩产计划。村田旗下子公司出云村田制作所表示，规划在日本岛根县兴建新工厂，目标 2030 年完工；国巨将在中国台湾建设第六座厂区，未来将引入晶圆电阻、MLCC 生产线。

- **英飞凌与本田携手开发汽车半导体解决方案，汽车芯片成长前景可期**

英飞凌将为本田提供技术支持，帮助其打造具有竞争力的汽车。这些技术支持将主要集中在功率半导体、高级驾驶辅助系统（ADAS）和电子电气架构等领域。以此为基础，双方将携手开发新的架构概念。

三、终端市场动态

终端市场动态概览			
维度	厂商	经营动态	解读
人工智能	OpenAI	发布文生视频模型 Sora	AI 模型持续迭代
	魅族	停止传统智能手机新项目开发，投入新一代 AI 设备	AI 技术推动硬件变革
	苹果	停止电动汽车项目，聚焦生成式 AI 业务	看好 AI 模型应用增长
新能源	南网储能	与蔚来进行储能战略合作	看好储能市场增长
	蜂巢能源	与泰国 Banpu NEXT 战略合作深化本地化布局	看好泰国储能市场需求增长
	杜克能源	或将停用宁德时代储能电池	美国封锁冲击国内厂商业务
汽车	大陆集团	将从研发部门削减 1750 个工作岗位	欧洲市场需求相对疲软
	Forvia	计划将在欧洲裁员 10000 人	欧洲市场需求相对疲软
	大众	与小鹏汽车已签署平台与软件联合开发技术合作协议	车企继续降本增效
	宏景智驾	为江淮瑞风 RF8 提供智能摄像头以及 ADAS 高阶辅助驾驶软件系统	看好国内智能化趋势

(一) 人工智能

● OpenAI 发布文生视频模型 Sora，展现 AGI 落地应用可能性

近期，OpenAI 发布文生视频模型 Sora，目前支持通过文字或图片生成长达 60 秒的视频，还支持在时间上向前或向后扩展视频，以及视频编辑。OpenAI 表示其正在训练 AI 理解和模拟运动中的物理世界，目标是训练模型帮助人们解决需要现实世界交互的问题。

Sora 的 AI 训练思路与特斯拉 FSD V12 技术相似：并非训练 AI 如何生成视频，而是训练 AI 理解和生成一个真实的场景或者世界，视频只是从某一个视角观察这个场景的一段时空。未来车端世界模型的实现速度可能会加快。这不仅能提高云端数据仿真、测试的效率，还能解决 AI 智能驾驶的可解释性问题，为达到 L4 级自动驾驶铺平道路。

● 魅族停止传统智能手机新项目开发，投入新一代 AI 设备

魅族宣布进行战略调整，在 All in AI 的同时，将停止传统智能手机新项目开发，全力投入新一代 AI 设备。魅族首款 AI Device 硬件产品将在今年内正式发布，并在未来三年累计推出 6 款硬件产品，除了今年的 1 款外，还包括 2025 年 2 款——全天候 AI Device（XR 形态）、AI Device 迭代，以及 2026 年 3 款——全天候 AI Device、AI Device 迭代、AI Device PR0。可见，近期手机厂商加快切入 AI 赛道，看好 AI 市场未来成长空间，根据 Precedence Research 预测，2030 年全球 AI 芯片市场规模有望达到 1352 亿美元。

● 苹果停止电动汽车项目，聚焦生成式 AI 业务

苹果停止运作近 10 年的造车项目，转而投入生成式 AI 业务，从事汽车研发的员工将被调整至人工智能部门。

（二）新能源

● 南网储能与蔚来进行储能战略合作

南网储能科技与蔚来能源签署协议，在虚拟电厂、换电站业务、电池梯次和回收利用等领域展开全面合作，推动充换电站、储能站、可调负荷等聚合资源接入虚拟电厂平台。

● 蜂巢能源与泰国 Banpu NEXT 战略合作深化本地化布局

蜂巢能源与国际能源巨头万浦集团的子公司 Banpu NEXT 签署战略合作协议，进一步深化双方在储能、电芯、回收领域的本地化合作和布局，保持蜂巢能源泰国工厂在泰国、东南亚等国家或地区的锂电行业领先优势。

● 杜克能源或将停用宁德时代储能电池

美国公用事业公司杜克能源表示，在美国国会的压力下，杜克能源计划在美国最大的海军陆战队基地勒琼营停用中国电池制造商宁德时代生产的储能电池，采用其他供应商产品，并将逐步在民用储能项目中停用宁德时代的电池产品。

（三）汽车

● 欧洲汽车市场持续疲软，汽车零部件供应商陆续实施裁员

德国汽车供应商大陆集团将从研发部门削减 1750 个工作岗位，全球第八大汽车供应商 Forvia 计划将在欧洲裁员 10000 人。预计欧洲汽车市场短中期内将持续下滑。

● 大众与小鹏签署技术合作协议，拟通过联合采购优化成本结构

大众汽车与小鹏汽车已签署平台与软件联合开发技术合作协议。根据协议，双方将通过联合采购计划，对共用的汽车及平台零部件进行采购，优化成本结构，共同开发两款面向中国中型车市场的智能网联车型，其中首款车型为 SUV。通过联合采购，以及在车辆设计和工程阶段应用创新技术，产品开发周期将大幅缩短超 30%。

● 宏景智驾为江淮瑞风 RF8 提供智驾产品

宏景智驾宣布，为江淮瑞风 RF8 提供智能摄像头以及 ADAS 高阶辅助驾驶软件系统。在基础智驾版本瑞风 RF8 车型上，配备有 1 颗前视摄像头、2 颗毫米波雷达，可实现 L2 级智能驾驶辅助。其中，智能前视摄像头内置地平线征程 3 视觉感知芯片，搭配国产 MCU 芯驰 E3420。此外，在后续高阶智驾版本瑞风 RF8 车型上，将采用宏景智驾自研的智能驾驶域控制器产品以及高阶智能驾驶算法，可实现在高速场景上的导航辅助驾驶能力。

四、重点产品行情

（一）存储：终端需求上涨承压，部分存储芯片贸易氛围浓烈

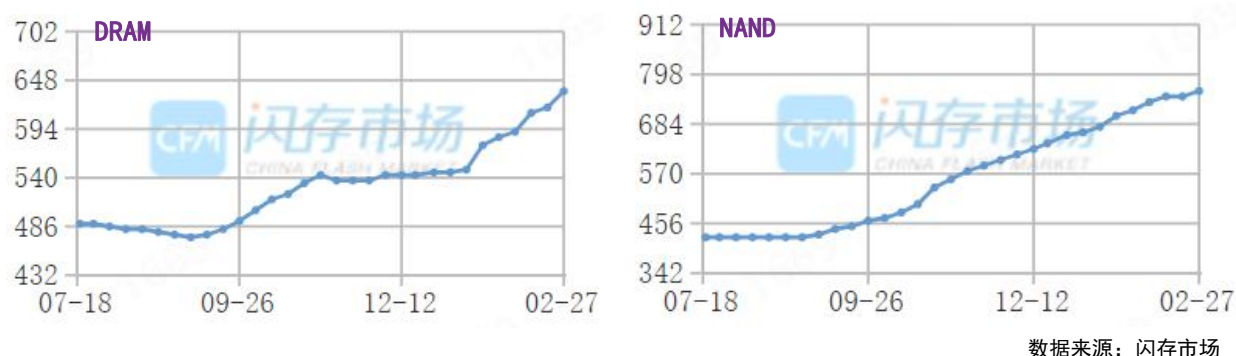
节后至今存储市场需求平淡，原厂部分嵌入式价格出现松动，服务器市场需求较为稳固。

现货市场资源控货涨价，倒挂压力持续存在，wafer 贸易氛围浓烈，成品端整体涨幅收敛。

总体来看，目前原厂重点仍在于涨价盈利、找补亏损，但来自需求端的压力逐步显现，节后头部终端拉货动能收敛，压制短期上涨势头，存储涨价行情进入新一轮博弈阶段。

从全年来看，根据 Techinsights 最新数据，内存销售额增速今年或将超过 70%。

DRAM 及 NAND 价格指数



（二）功率：总体仍处于供过于求阶段，价格上涨动能不足

功率器件仍处于供过于求阶段，价格端尚未全面上涨，以英飞凌 IRF640NPBF 型号 MOSFET 为例，2 月平均报价下降将近 5%，库存上升 3%，也验证了上月部分国内中小厂商涨价主要系成本压力。

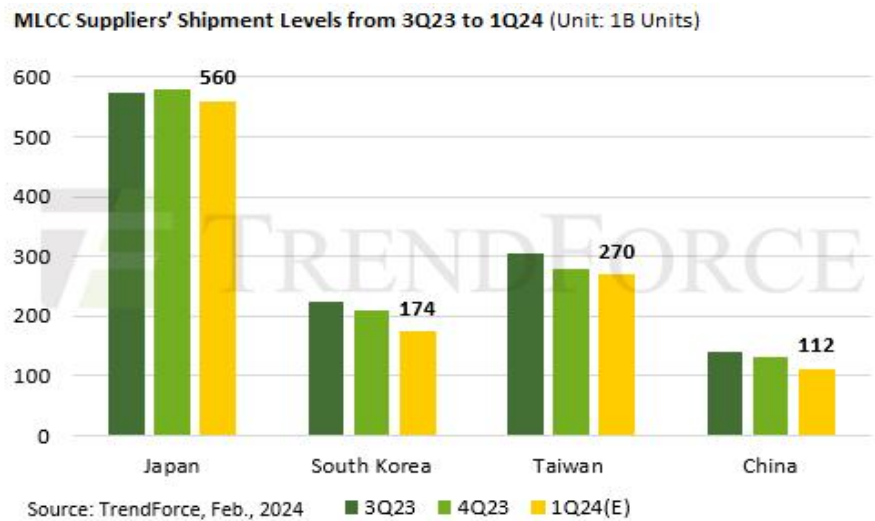
IRF640NPBF 型号库存及价格走势



（三）被动：订单需求放缓，预计第一季度 MLCC 出货环比减少 7%

TrendForce 数据显示，预计 24 年 Q1 的 MLCC 出货总量仅达 11103 亿颗，环比减少 7%，目前市场仍处于供过于求状态。TrendForce 预计，第一季度 MLCC 供应商平均 BB Ratio（订单/出货比）可能下滑至 0.89，环比减少 3.3%。面对订单需求增长放缓，MLCC 供应商报价策略也转趋保守，并持续管控产能。

MLCC 厂商出货量（十亿颗）



数据来源：TrendForce

（四）MCU：整体市场持续疲软，部分通用类器件交期缩短

2 月，MCU 市场整体仍然疲软。NXP 品牌的 MCU 整体库存较高，货期进一步缩短；MICROCHIP 的部分车规类 MCU 交期仍然较长。

品牌	产品系列	交期（周）	交期趋势
NXP	传统 16 位 MCU（S912x）	13-25	进一步缩短
	传统 32 位 MCU（MK64x、MK70x）	18-54	交期不稳定
	通用类 MCU（LPC17x）	13-50	进一步缩短
	汽车 MCU（MP5x、FS32x、MCFx）	36-54	无明显变化
MICROCHIP	8 位 MCU（PIC16x、AT89x、ATMEGA25x）	6-12	基本正常
	16 位 MCU（PIC24x、DSPIC3x）	6-30	部分型号明显缩短
	32 位 MCU（ATSAMA5x、PIC32x）	4-14	大部分交期缩短，少量型号还是长交期

五、市场重点趋势

● HBM 市场景气度继续上升，AI 模型复杂化正推动 HBM 发展

SK 海力士、美光科技存储两大厂表示 24 年 HBM 产能已售罄。未来在 AI 模型逐渐复杂化的趋势下，英伟达产品所采用的 HBM 将升级至 HBM3E，新一代 B100 产品将进一步拉升市场对 HBM 的容量需求；AMD 产品仍采用 HBM3，预计下一代 MI350 将升级为 HBM3E；而英特尔产品仍将使用 HBM2E。

● MLCC 短期订单需求放缓，长期增长仍然可期

目前 MLCC 市场仍处于供过于求状态，TrendForce 预计 24 年 Q1 的 MLCC 出货量环比减少 7%。但是，被动元件大厂如村田、国巨等，近期均宣布 MLCC 扩产计划，看好未来中长期需求增长。

● MCU 市场需求持续疲软，部分器件交期有所缩短

鉴于 MCU 市场需求上涨动能不足，美国 MCU 厂商 Microchip 减薪、停工，其 MCU 交期有所缩短，但车规类 MCU 交期仍然相对较长。

信息来源

- [1]美国加码打压中芯国际, 环球时报, 2024
- [2]India gives green light to chip plants worth \$15.2 bln, Reuters, 2024
- [3]Tokyo pledges a further \$4.9 bln to help TSMC expand Japan production, Reuters, 2024
- [4]Microchip cuts pay for some employees, SemiMedia, 2024
- [5]两会将至, 应该重点关注哪些产业投资机会, 招商证券, 2024
- [6]AI 需求强劲持续催化, HBM 或将迎来扩产大年, 财联社, 2024
- [7]TI 电源芯片研发团队, 全裁, 半导体产业网, 2024
- [8]三星调整芯片工厂建设计划, 应对市场需求变化, C114 通信网, 2024
- [9]半导体行业尚未全面复苏, 扩产稳步推进, C114 通信网, 2024
- [10]SK 海力士正考虑在印第安纳州建先进封装厂, 财联社, 2024
- [11]业界看好 MLCC 需求, 村田、国巨等大厂计划扩产, 集微网, 2024
- [12]英飞凌与本田签署战略合作备忘录, 英飞凌, 2024
- [13]Sora 惊艳发布, 文生视频跨越式突破, 国盛证券, 2024
- [14]魅族宣布将停止传统“智能手机”新项目, 向 AI 领域转型, 和讯网, 2024
- [15]Apple cancels decade-long electric car project, Reuters, 2024
- [16]南网储能科技与蔚来能源签署协议, 蔚来, 2024
- [17]蜂巢能源与泰国能源巨头 Banpu NEXT 达成战略合作, 中国日报网, 2024
- [18]杜克能源或将停用宁德时代储能电池, 索比储能网, 2024
- [19]欧洲零部件裁员潮来势汹汹, 中国汽车报, 2024
- [20]小鹏汽车与大众签订联合开发协议及订立联合采购计划, 小鹏汽车, 2024
- [21]从 ADAS 到高速 NOP, 宏景智驾助力江淮瑞风 RF8 智驾突破, 亿欧汽车, 2024
- [22]MLCC Shipments to Dip 7% in 1Q24 Amid Slowing Order Demand, TrendForce, 2024
- [23]存储行情再起风云, 部分主流市场价格小幅向下调整, 唯资源涨价势头不减, 闪存市场, 2024

免责声明

安芯易电子商务（深圳）有限公司（下称“安芯易公司”）所发布的月度报告由安芯易公司市场部基于现已公开的资料、信息、研究报告等进行整理编制而成。

本报告所载的资料、意见及推测仅反映安芯易公司在报告发布当期的判断、观点，仅供学习参考之用，不构成对所述产品的出价、征价、要约或要约邀请，不构成任何合同或承诺的基础，不构成买卖任何投资工具或者达成任何交易的推荐，亦不构成任何投资、采购及其他应用建议和指导，对任何因直接或间接使用本报告涉及的信息和内容或者据此进行交易、投资所造成的一切后果或损失，安芯易公司不承担任何法律责任。因此，读者在阅读本报告时应保持警惕，并进行独立的判断和分析。

安芯易公司对本报告中所引用的资料、研究报告所涉及的或从第三方媒体获得的信息及数据的真实性、准确性、完整性和及时性不作任何明示或默示的保证。所发布的信息、观点以及数据有可能因发布日之后的情势或其他因素的变更而不再准确或失效，但安芯易公司不承担更新不准确或过时的信息、观点以及数据的义务，在对相关信息进行变更或更新时亦不会另行通知。

该报告版权归安芯易公司及相关内容提供方所有，未经授权，任何人不得以任何方式转载、修改、翻版、分发、复制、发表。

安芯易电子商务（深圳）有限公司

2024 年 3 月



安芯易隶属于Ample Solutions集团,成立于2008年。作为亚洲首选的电子元器件分销商,多年来专注于为全球电子制造业客户提供元器件全球采购及供应链服务。我们的团队始终践行着“专注、专业、坚韧、谦卑”的核心价值观,为客户提供极致的服务,帮助客户成功。

我们拥有150+专业资深采购团队,与全球9000+供应商深度合作,致力于用更快的速度、更低的成本,为客户解决电子元器件短缺问题。

我们在深港两地建立了业界最大的品质控制中心,以超越国际标准的品质控制体系,从供应商管控到品质检测全方位防范风险,为客户的元器件供应链安全保驾护航。



洞察行情 精准决策

